

自動車技術会 2026 年秋季大会
ランチョンセミナーのご案内



紙づくり技術が拓く 次世代モビリティ向け材料

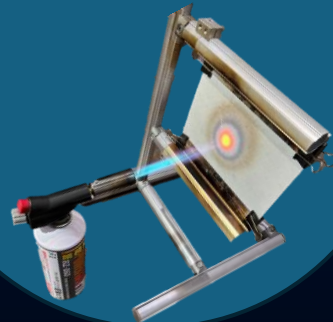
高摩擦材料



低高摩擦材料



熱制御材料



※画像はイメージです。

日時

2026年 10月 14日 (水)
10:55~11:25
※昼食 (お弁当) 付き

登壇者

株式会社ダイナックス 商品開発本部
次長・博士 (工学)
神田航希 氏

会場

札幌コンベンションセンター
2階 207 (定員50名)

本セミナーは、事前登録制となります。
右記QRコードからお申込みください。
展示ブースにも出展しております。
ぜひ弊社ブースへもお越しください。

